

GENIDEAS[®]

聚賢研發股份有限公司

2026上半年法人說明會

股票代號 **7631**



反省



創新



即時



共好

免責聲明



- 本簡報相關訊息內容取自於公司內部與外部蒐集之資料，其中包含營運成果、財務狀況、業務發展與產業現況等內容。
- 本公司並未發佈財務預測，本簡報所作有關本公司財務、業務或Q&A之說明，若涉及本公司對未來公司經營與產業發展之見解，可能與未來實際結果存有差異，造成差異之原因可能包括科技演進、市場需求變化、原料價格波動、競爭行為與國際經濟景氣變動等各種風險因素。
- 本簡報內容並非投資建議，本公司不對內容的正確性、完整性或任何使用本簡報內容所產生的損害負任何責任。

大綱



01

公司簡介

02

營運策略與研發能力創新

03

創新產品與專利

04

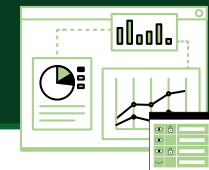
聚賢永續行動

05

業務發展暨財務績效

01.公司簡介





經營團隊

董事長 曾國強 | 總經理 鄭惠芸



公司成立

2018年1月



上市日期

2025年3月13日



全球員工人數

170人



資本額

NTD 2.01億



廠務工程

- 高科技廠房MEP機電工程
- 高科技廠房整合二次配系統裝機工程
- 高科技廠房氣體供應系統設計施工工程



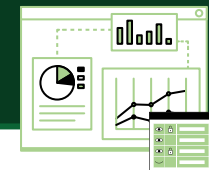
設備及零組件 設計開發

- 管路工藝流程優化，機構及輔治具開發
- 製程設備零組件及耗材設計開發
- 全方位售後服務與技術支持



跨領域技術 整合創新應用

- 半導體雷射技術延伸應用
- 自動化與智慧製造整合
- 客製化技術解決方案



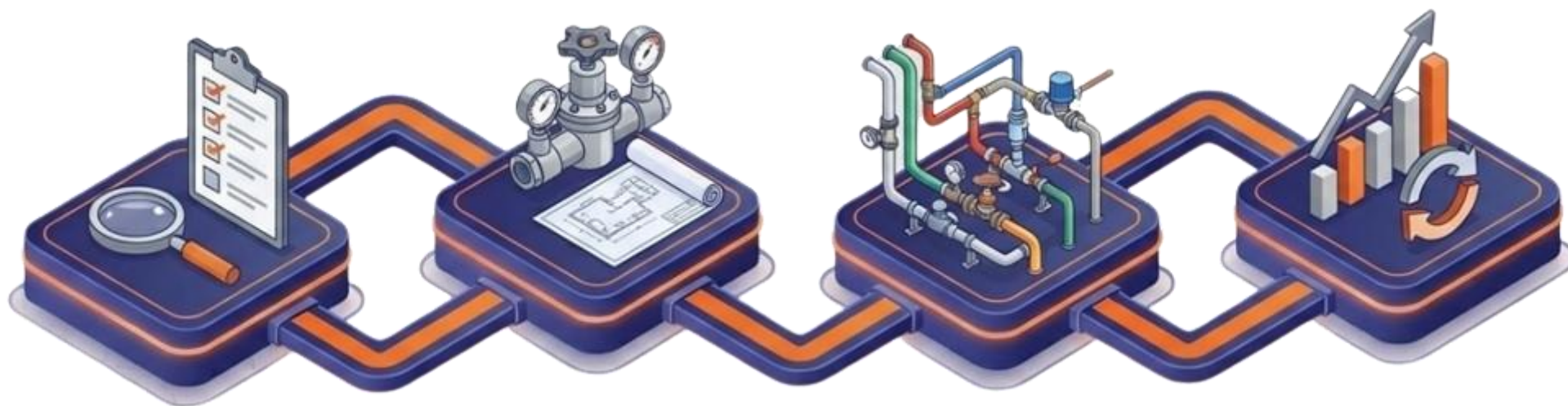
跨領域關鍵技術服務與創新產品

從使用者需求
與問題出發

製程設備所需
零組件耗材
設計開發製造

高科技廠房
MEP機電
供應系統領域佈局

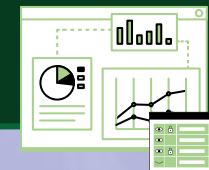
全方位
售後服務
技術支持



創新優化客戶生產流程及設備

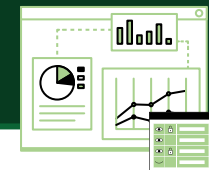
引導改良氣體二次配工程施工作



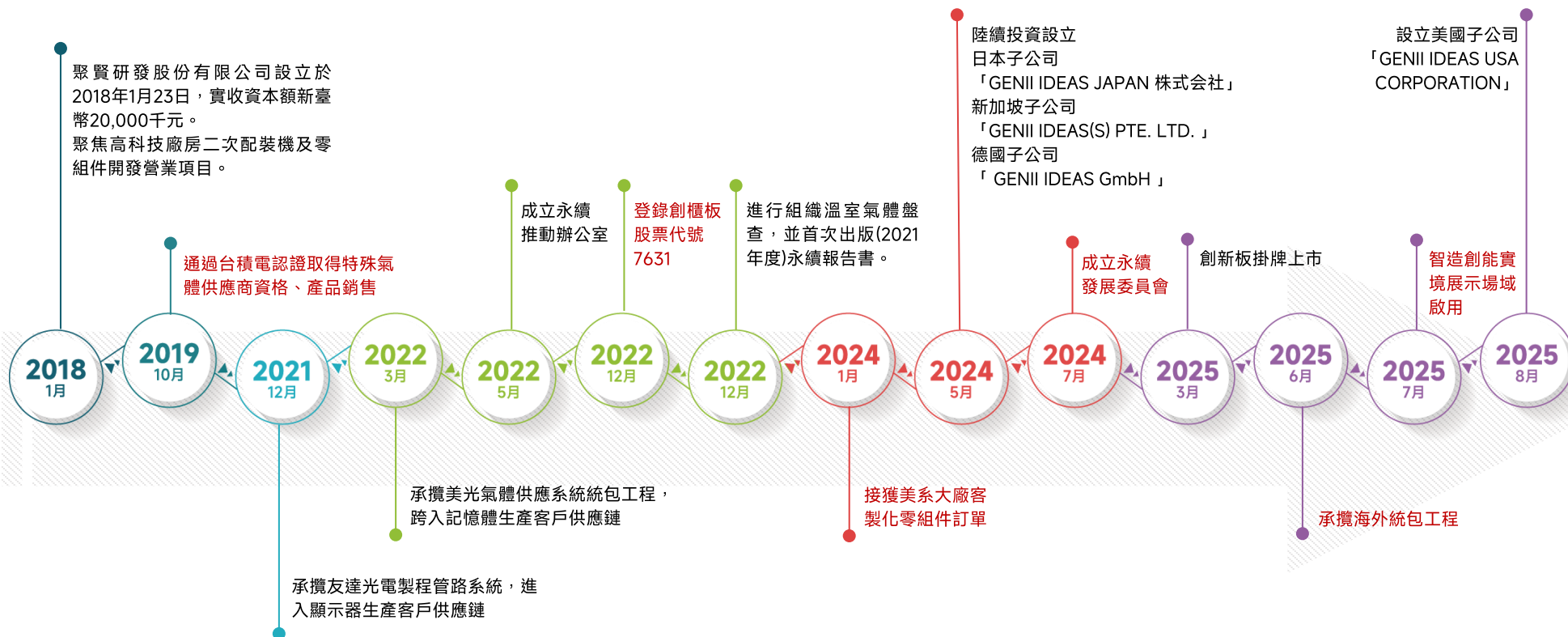


因應氣候變遷及行動下

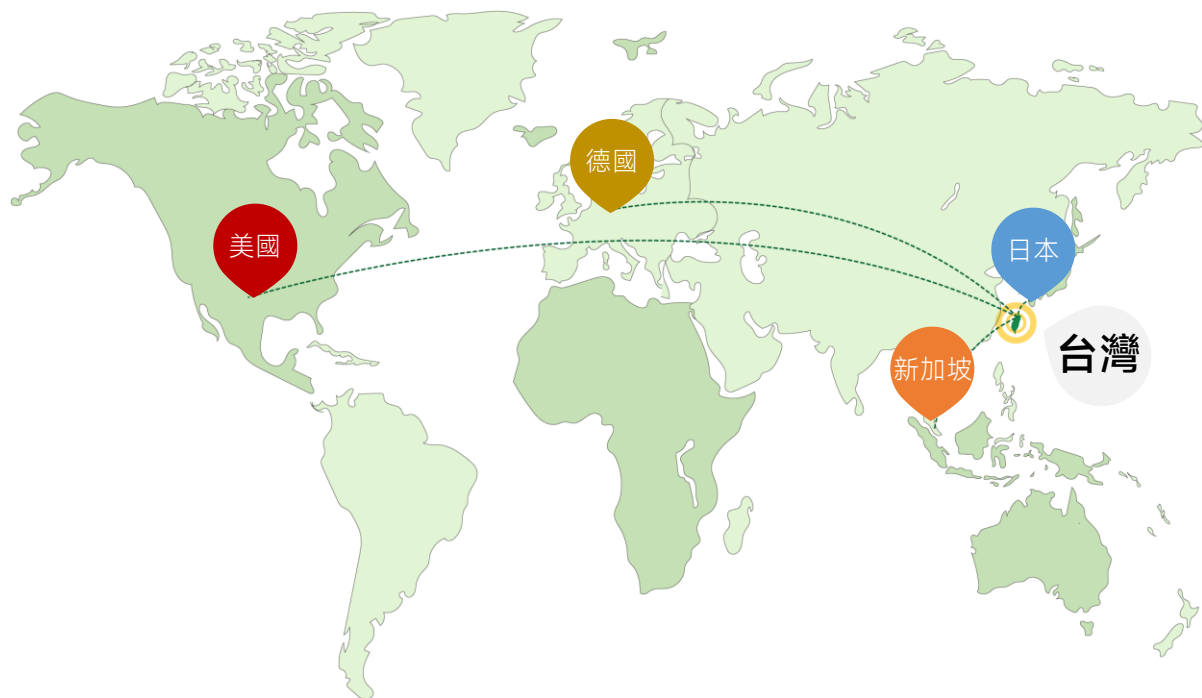
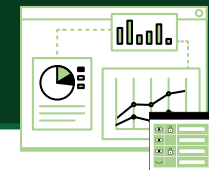
「高科設備優化最佳服務商」



公司經營重要歷程

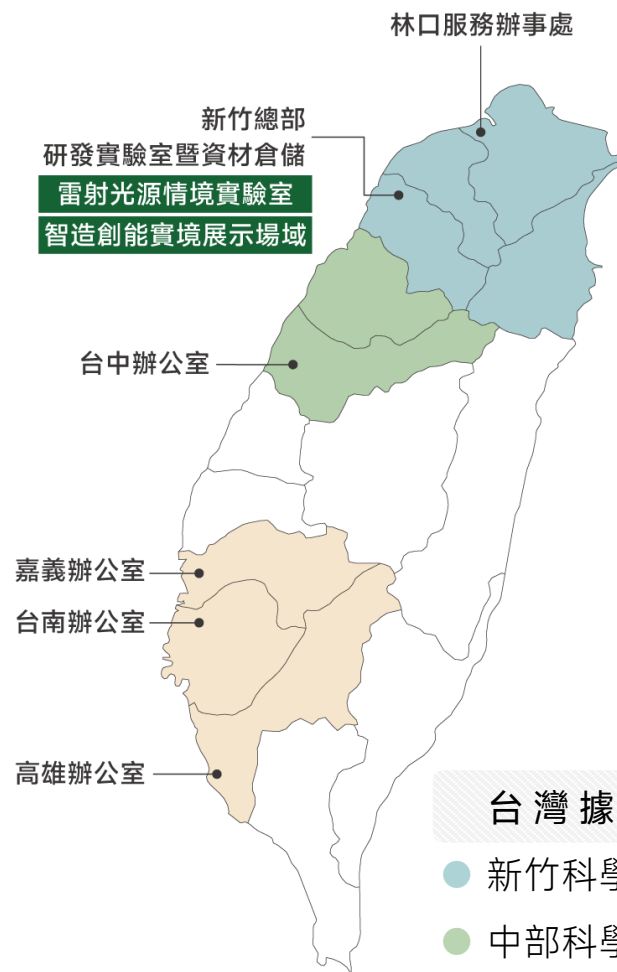


全球服務據點



海外子公司

- 日 本：熊本
- 德 國：德勒斯登
- 新加坡
- 美國：亞利桑那 (Arizona)

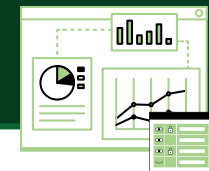


台灣據點

- 新竹科學園區
- 中部科學園區
- 南部科學園區

02. 營運策略與研發能力創新





整合智慧農業與智慧建築，打造零碳排生態圈

智慧農業 | 低碳自供電型溫室 **攜手工研院**

農電共生

將鈣鈦礦技術導入沙崙綠能示範場域的溫室

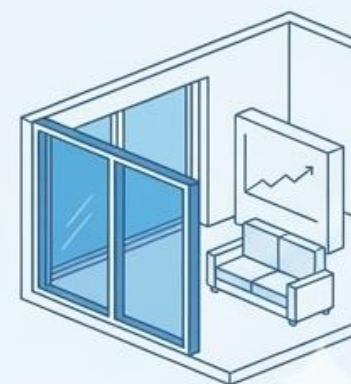
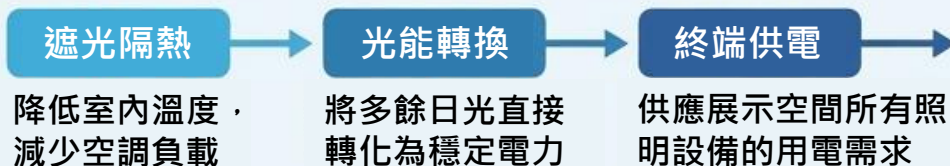
- ✓ 實現高經濟作物的低碳與綠能生產
- ✓ 溫室自主供電，有效降低農場整體消耗
- ✓ 提升科技農業競爭力，邁向2050淨零碳排目標

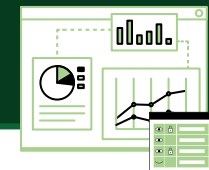


智慧建築 | 鈣鈦礦創能門窗

從「展示」走向「日常資源循環」

聚賢 SHOWROOM 落地窗升級，讓建築主動參與發電節能





資源循環與低碳製程

氣體回收、純化與再利用



再生能源



氫氣

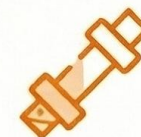


氦氣

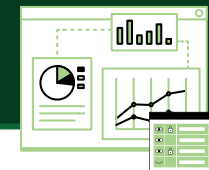


針對再生能源、氫氣及氦氣進行回收處理，轉化為可重複利用的資源。

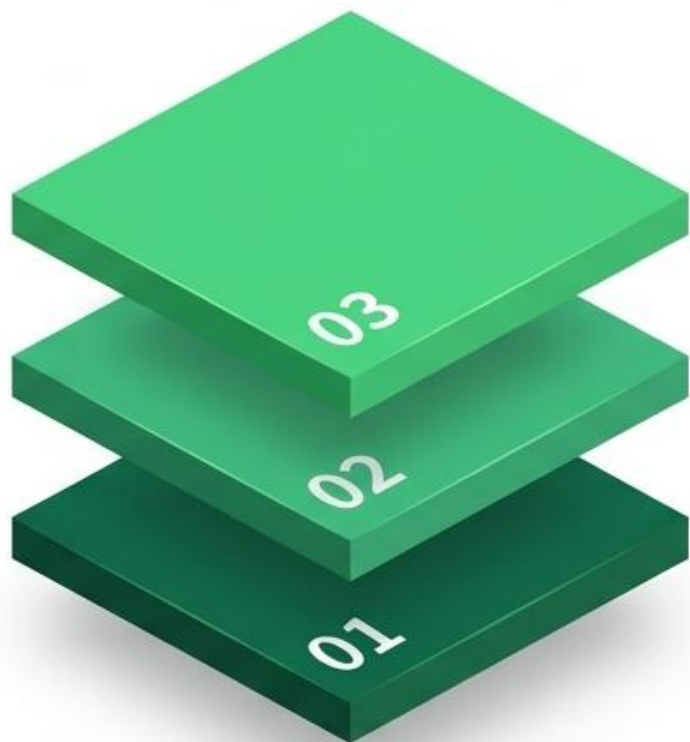
超臨界 CO2 清洗與萃取



運用超臨界 CO2 流體特性，執行高效率的零件清洗或材料成分萃取。



建立關鍵技術堆疊優勢



跨領域不同場景技術應用

雷射光學 材料科學 自控領域 機械加工

多重技術堆疊大幅提高模仿難度

綜合軟硬體整合能力

無縫串聯底層硬體與控制系統，提高產品服務綜效

自主研發綠色多元產品

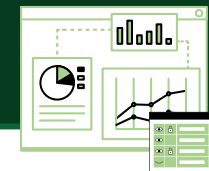
節能減碳 材料輕量 全循環回收

全面對齊淨零策略，實質優化客戶端流程效率

03. 創新產品與專利



創新產品-管路自動雷射焊接系統



Genii LaserWelder 全方位雷射焊接系統：從細管到大管的全效解決方案



智慧大腦：
人機介面控制器
(HMI Controller)

直觀圖像介面，參數
設定與即時監控



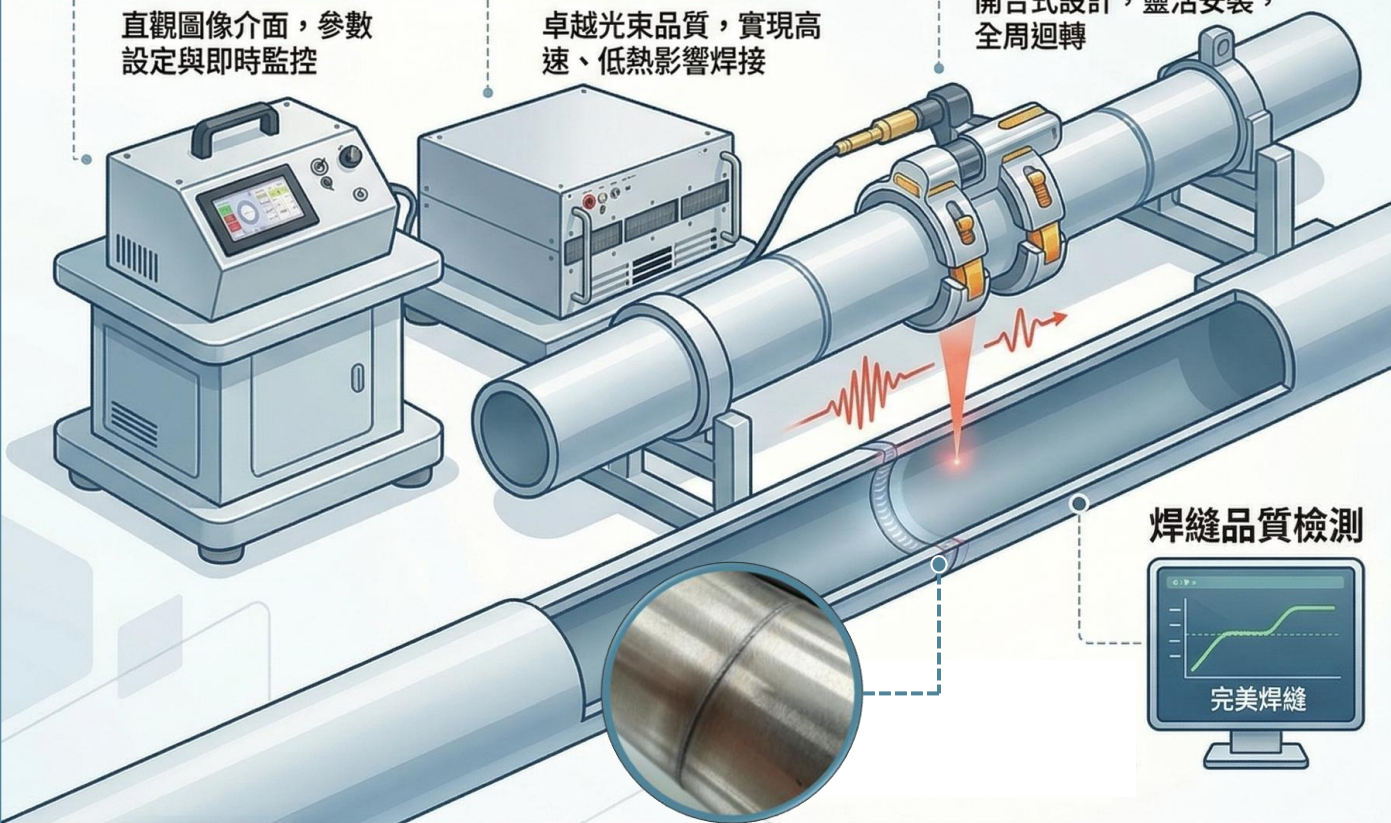
能量心臟：
500W 光纖雷射主機
(Fiber Laser)

卓越光束品質，實現高
速、低熱影響焊接

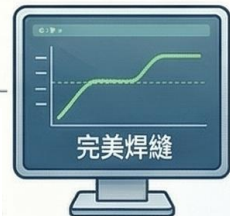


精準之手：
自動化雷射焊把總成

開合式設計，靈活安裝，
全周迴轉



焊縫品質檢測



完美焊縫

F-Type (細管小徑)



管徑：6A - 25A (1/8" - 1")
應用：半導體高純度氣體系統
特色：輕巧靈活

E-Type (中管中徑)

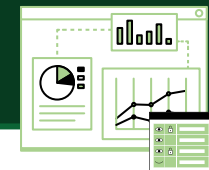


管徑：32A - 100A
應用：半導體製程真空系統
特色：精準雷射續接技術

G-Type (大管大徑)



管徑：100A 以上
應用：石化、化工、能源產業
特色：大型管路客製化



極細微金屬切割

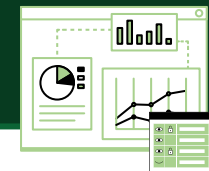


電性量測



雷射玻璃精密加工





管路抗結晶震動裝置：雙效解決方案

核心痛點與創新對策

客戶痛點：製程管路結晶堵塞



傳統加熱方式效果有限，
且較為耗能。

雙效解決方案：
震動延緩結晶+聲波即時偵測

管路抗結晶震動裝置

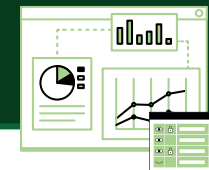
採用夾持式設計，不影響
既有管線，易於安裝。

功能一：機械震波，有效延緩結晶

通過加嚴高強度耐久測試，
證實可剝離模擬結晶。

功能二：聲波分析，即時監測堵塞

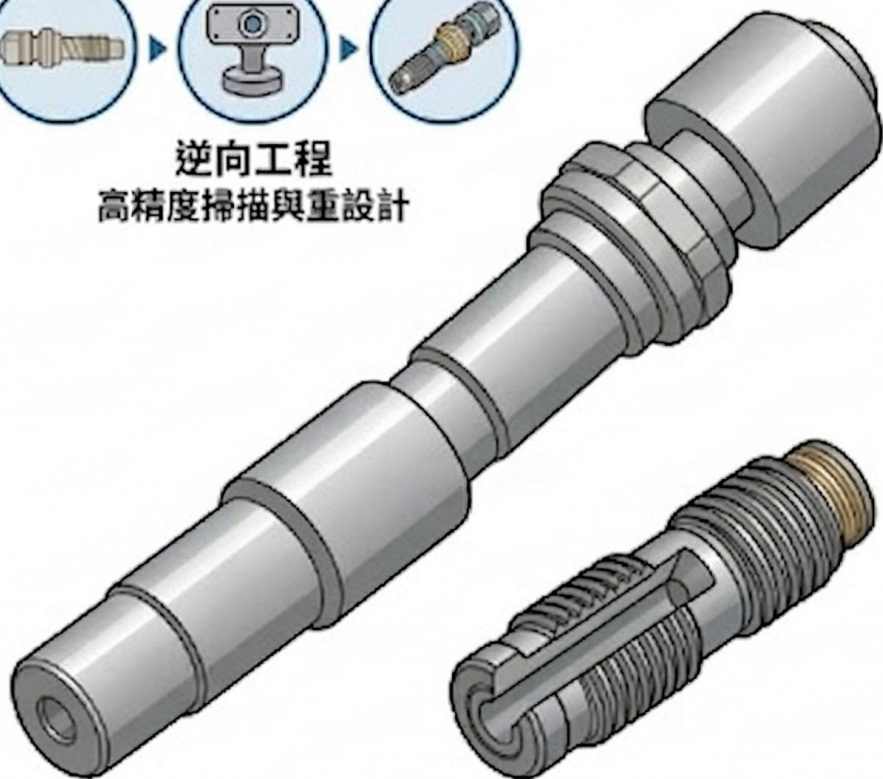
將堵塞程度轉為可視化百分比，
建議安裝於堵塞點±50公分內。



1. 半導體設備固定PIN



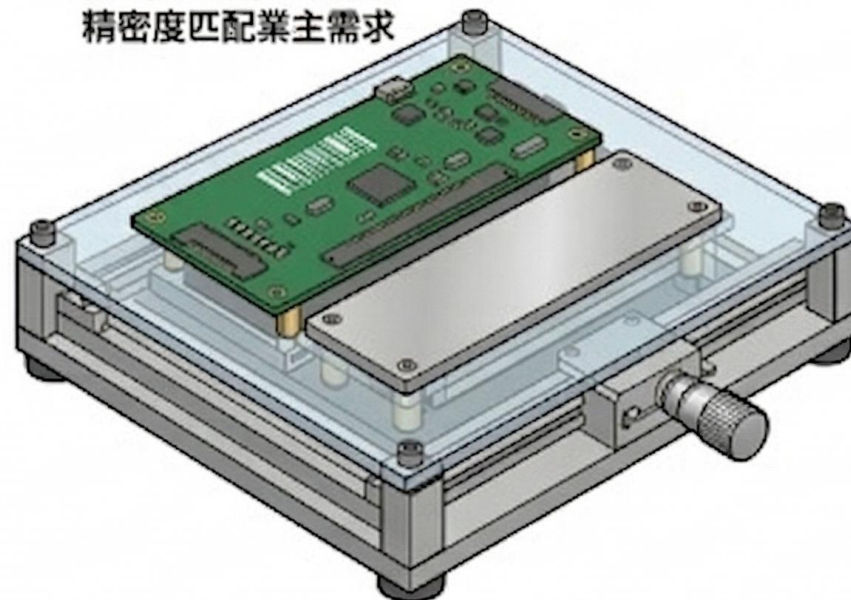
逆向工程
高精度掃描與重設計



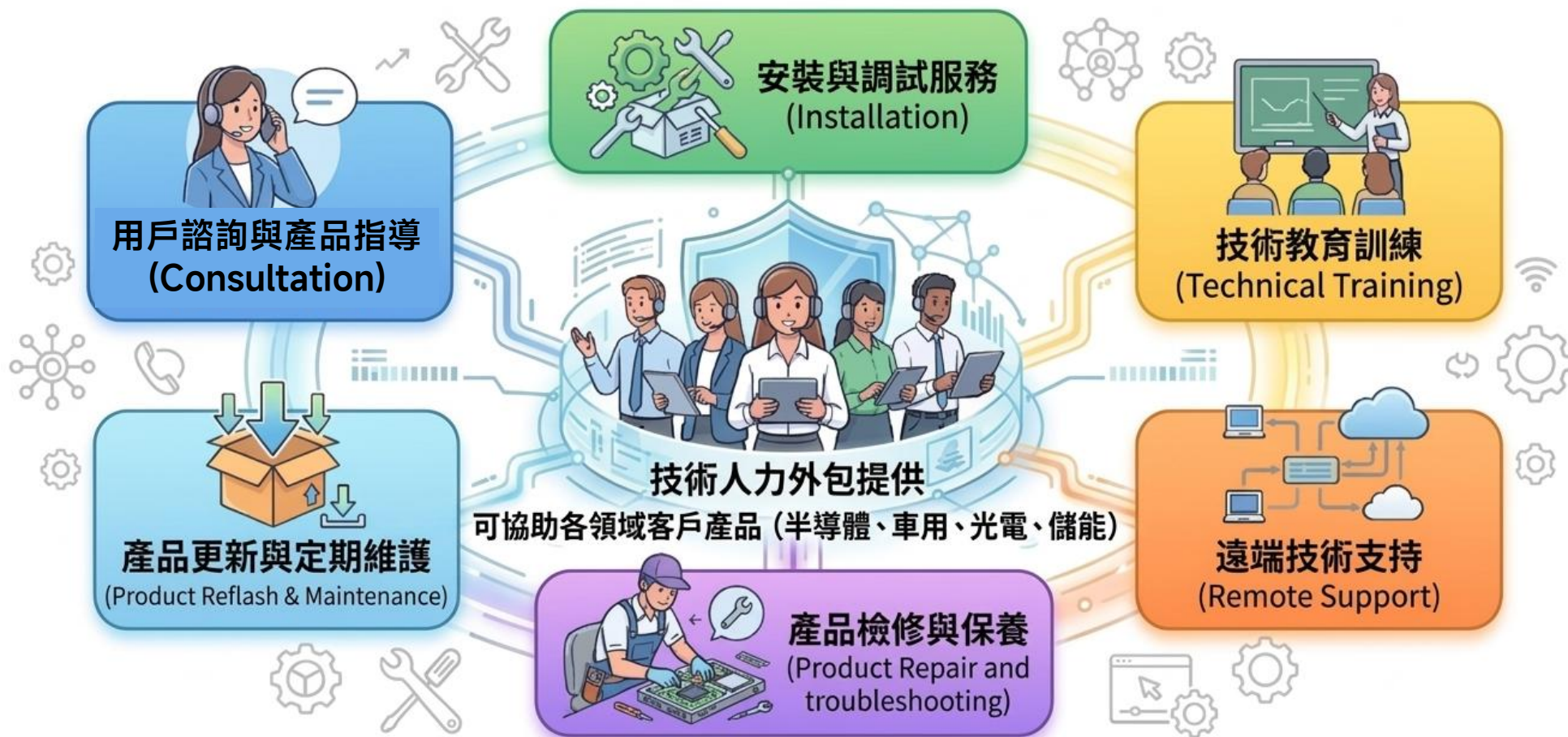
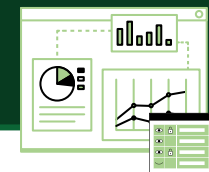
2. PCB板量測治具開發



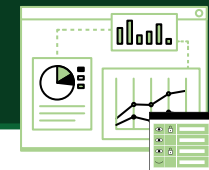
精密量測治具開發
精密度匹配業主需求



全方位售服及技術支持



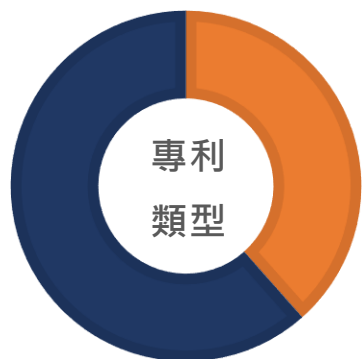
創新能力-專利佈局



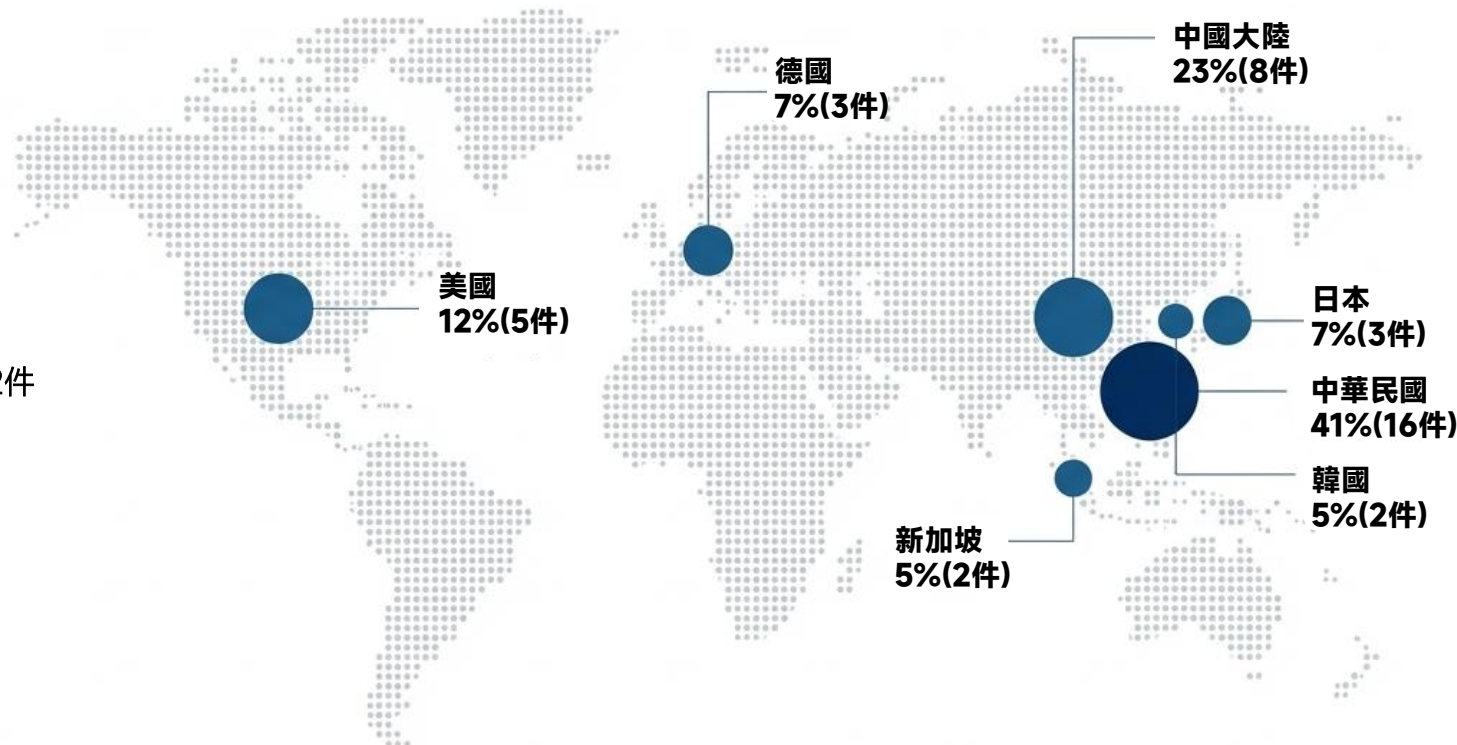
- 有效專利 44%(17件)
- 審查中專利 56%(22件)

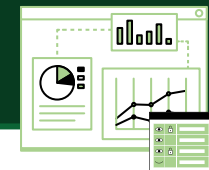
有效專利：發明4件、新型13件

審查中專利：發明20件、新型2件



- 新型專利 38%(15件)
- 發明專利 62%(24件)





投入資源佈局未來

第一主軸：人才資源戰略

內部深耕 | 建構專業人才庫

強化技術職能以打造核心優勢；建置知識庫加速經驗傳承。

外部引水 | 延伸學研合作

深化產學對接以穩固人才儲備；透過協作平台接軌前瞻趨勢。

創新能力- 資源投注

第二主軸：研發動能強化

內部精進 | 優化執行效能

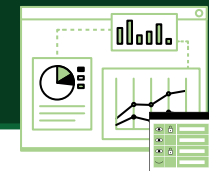
持續深耕核心設計能力，提升解決方案品質。

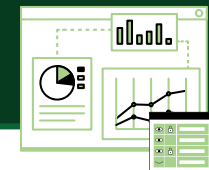
外部賦能 | 擴大供應商策略合作

整合外部技術資源加速研發；優化供應鏈以提升協作效率。

04.聚賢永續行動







環境關懷

綠色製程
低碳通勤
能源轉換
推動無紙化
永續發展委員會



公司治理

營業秘密
性別平等
激勵獎金
EAP制度
在職進修



社會加值

公益假
樂活假
公益信託
美麗台灣
產學合作





以卓越技術驅動產業升級，以永續發展實踐企業承諾

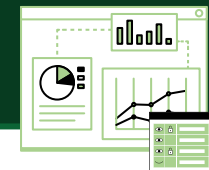


榮獲 **2024 MM ESG Award**



供應商 ESG 聯合提案：
卓越影響獎 **伍獎**





以卓越技術驅動產業升級，以永續發展實踐企業承諾

【創新研發 Innovation】

【永續經營 ESG】



2025 台灣創新技術博覽會 (TIE)
發明競賽 銅牌

2025 第十八屆台灣企業永續獎 (TCSA)
企業永續報告書 銅獎

05.業務發展暨財務績效





產業趨勢與市場預測

市場規模與增長預測



關鍵技術創新



先進封裝與Chiplet
異質整合



亞2nm節點採用
EUV顯影技術與
GAA電晶體



第三代半導體材料
SiC和GaN應用增長

終端應用驅動



汽車電子



高性能計算



網絡通訊

供應鏈與區域發展



區域性在地化生產



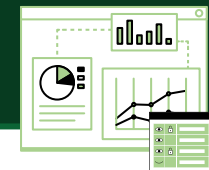
供應鏈韌性



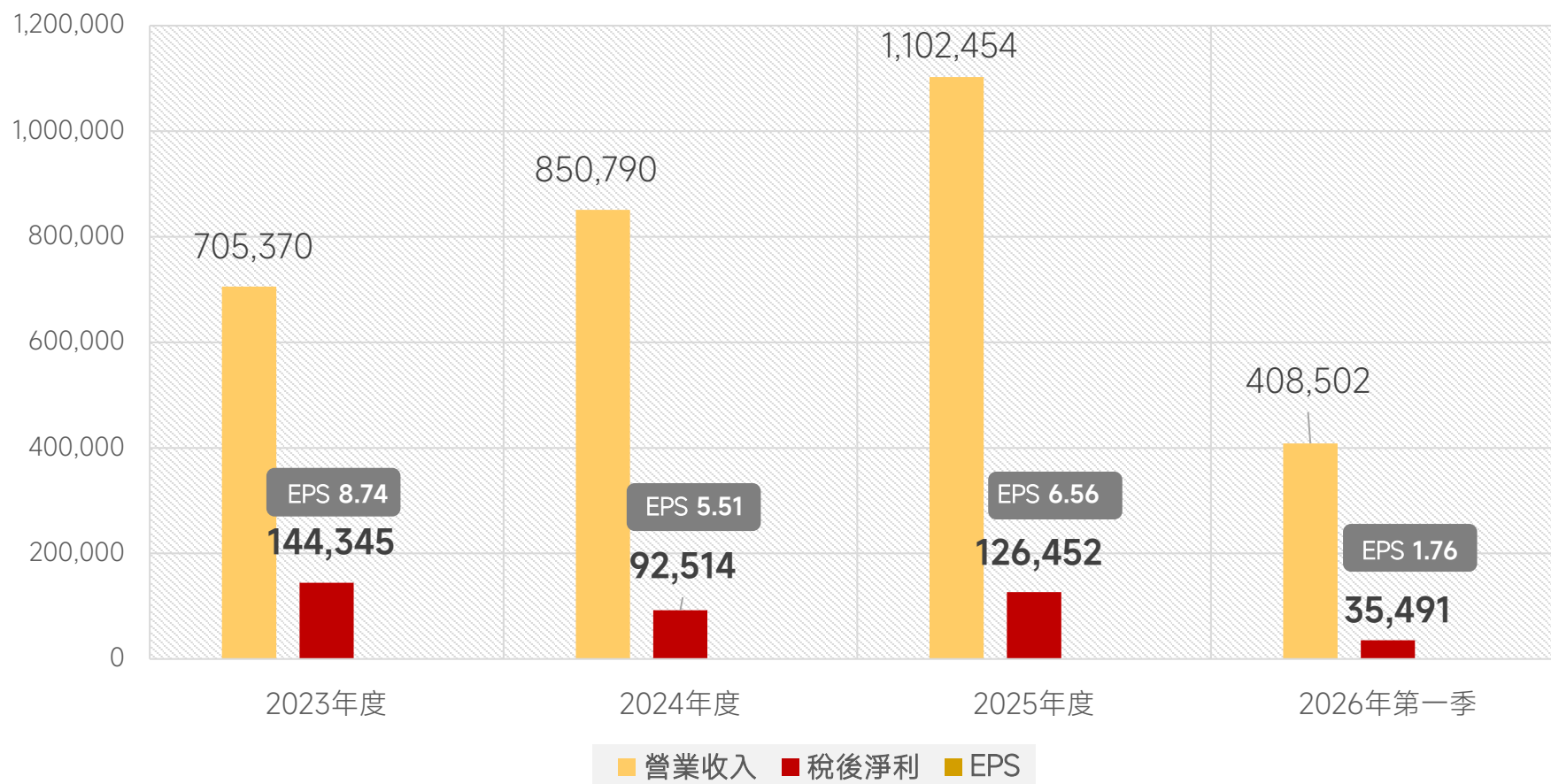
晶圓產能管理

資訊來源：參考國內外半導體及技術報導

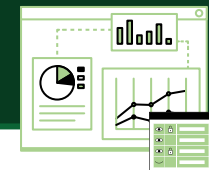
最近三年度及本年度最近期營收及稅後淨利



2023~2026年第一季經營績效



註：財務數據業經安永聯合會計師事務所查核簽證或核閱



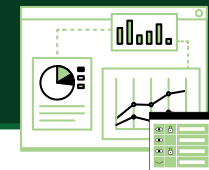
綜合損益表

2023~2026年第一季

單位：新台幣仟元

會計項目/期間	2023年度	2024年度	2025年度	2026年第一季	YOY(%)
營業收入	705,370	850,790	1,102,454	408,502	99.34%
毛利率	39.93%	31.26%	27.52%	22.99%	(21.48)%
營業費用	102,357	127,155	149,874	46,373	16.40%
營業利益	179,304	138,813	153,593	47,524	135.75%
營業利益率	25.42%	16.32%	13.93%	11.63%	18.19%
稅後淨利	144,345	92,514	126,452	35,491	112.33%
純益率	20.46%	10.87%	11.47%	8.69%	6.50%
EPS(元)	8.74	5.51	6.56	1.76	83.33%
權益報酬率	34.82%	18.67%	18.72%	16.78%	58.30%

註：財務數據業經安永聯合會計師事務所查核簽證或核閱



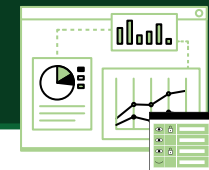
資產負債表

2023~2026年第一季

單位：新台幣仟元

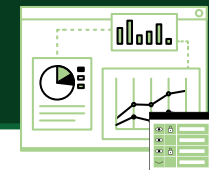
會計項目/期間	2023年度	2024年度	2025年度	2026年第一季	YOY(%)
現金及約當現金	255,325	208,743	610,574	481,233	192.50%
應收帳款	79,003	192,543	99,413	81,562	(48.37)%
存貨(含合約資產)	340,996	400,201	486,005	709,236	21.44%
總資產	754,999	1,008,599	1,483,072	1,567,579	47.04%
流動負債	253,107	340,945	478,222	556,998	40.26%
非流動負債	20,753	157,763	163,916	159,276	3.90%
負債總計	273,860	498,708	642,138	716,274	28.76%
重要財務指標					
負債比	36.27%	49.45%	43.30%	45.69%	(12.44)%
存貨周轉率(次)	1.29	1.58	1.80	2.11	13.92%
應收帳款週轉率(次)	6.23	6.27	7.55	18.06	20.41%

註：財務數據業經安永聯合會計師事務所查核簽證或核閱



採季配股利方式，兼顧成長與穩定收益

年度	每股現金股利 / 盈餘配發率
2024年第一季	0.50元
2024年第二季	0.50元
2024年第三季	0.59元
2024年第四季	1.20元
2024年度合計	2.79元 / 51%
2025年第一季	0.65元
2025年第二季	0.74元
2025年第三季	0.75元
2025年第四季	1.60元
2025年度合計	3.74元 / 59%
2026年第一季	0.80元 / 45%



研發費用占營收比重

單位：新台幣仟元

年度	2024年度			2025年度			2026年第一季		
公司名稱	研發費用	營業收入	比重%	研發費用	營業收入	比重%	研發費用	營業收入	比重%
聚賢研發	13,018	850,790	1.53	21,911	1,102,454	1.99	4,952	408,502	1.21
漢科	19,497	5,487,092	0.36	17,445	5,245,806	0.33	4,772	1,372,885	0.35
銳澤	4,721	1,951,312	0.24	10,932	2,564,418	0.43	2,490	539,517	0.46

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告

謝謝您的聆聽

Q & A



官方網站



2024 永續報告書

永續報告書下載

GENIDEAS[®]



反省



創新



即時



共好